

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

jc784 U.S. PTO  
09/735987  
12/13/00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

1 9 9 9 年 1 2 月 1 3 日

出 願 番 号  
Application Number:

平成 1 1 年 特 許 願 第 3 5 2 6 3 4 号

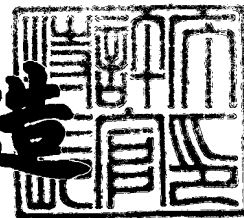
出 願 人  
Applicant (s):

株式会社村田製作所

2 0 0 0 年 1 1 月 1 0 日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Patent Office

及 川 耕 造



出 証 番 号    出 証 特 2 0 0 0 - 3 0 9 4 6 6 8

【書類名】 特許願

【整理番号】 199187

【提出日】 平成11年12月13日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01G 4/30

【発明者】

    【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号 株式会社村田  
                            製作所内

    【氏名】 宮崎 信

【発明者】

    【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号 株式会社村田  
                            製作所内

    【氏名】 田中 覚

【特許出願人】

    【識別番号】 000006231

    【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

    【代表者】 村田 泰隆

【代理人】

    【識別番号】 100085143

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 小柴 雅昭

    【電話番号】 06-6779-1498

【選任した代理人】

    【識別番号】 100103517

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 岡本 寛之

    【電話番号】 06-6779-1498

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 040970

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 積層型セラミック電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペーストおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 セラミックスラリー、導電性ペーストおよびセラミックペーストをそれぞれ用意し、

前記セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、前記セラミックグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらすように部分的に前記導電性ペーストを付与することによって形成された内部回路要素膜と、前記内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすように前記セラミックグリーンシートの前記主面上であって前記内部回路要素膜が形成されない領域に前記セラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物を作製し、

複数の前記複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体を作製し、

前記生の積層体を焼成する、

各工程を備える、積層型セラミック電子部品の製造方法であって、

前記セラミックペーストを用意する工程は、

少なくともセラミック粉末と第 1 の有機溶剤とを含む 1 次混合物を分散処理する 1 次分散工程と、

前記 1 次分散工程を経た前記 1 次混合物に少なくとも有機バインダを加えた 2 次混合物を分散処理する 2 次分散工程と、

前記第 1 の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第 2 の有機溶剤を前記 1 次混合物および／または前記 2 次混合物に含ませる工程と、

前記 2 次分散工程の後、前記 2 次混合物を加熱処理することによって、前記第 1 の有機溶剤を選択的に除去する除去工程とを備える、  
積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 2】 前記 1 次分散工程において、前記 1 次混合物は有機分散剤を含む、請求項 1 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 3】 前記第 1 の有機溶剤の 20℃における相対蒸発速度は、10

0 以上であり、前記第 2 の有機溶剤の 2 0℃における相対蒸発速度は、5 0 以下である、請求項 1 または 2 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 4】 前記セラミックペーストを用意する工程は、前記 2 次分散工程の後であって、前記除去工程の前に、前記 2 次混合物を濾過する工程をさらに備える、請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 5】 前記セラミックペーストを用意する工程は、前記有機バインダを前記第 1 の有機溶剤および／または前記第 2 の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製する工程と、前記有機ビヒクルを濾過する工程とをさらに備え、前記 2 次混合物は、前記濾過工程を経た前記有機ビヒクルの状態で加えられた前記有機バインダを含んでいる、請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 6】 前記第 1 の有機溶剤は、前記第 2 の有機溶剤より低い沸点を有する、請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 7】 前記第 1 の有機溶剤の沸点と前記第 2 の有機溶剤の沸点との差は、5 0℃以上である、請求項 6 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 8】 前記セラミックスラリーは、前記セラミックペーストに含まれる前記セラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含む、請求項 1 ないし 7 のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 9】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、誘電体セラミック粉末である、請求項 1 ないし 8 のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 1 0】 前記内部回路要素膜は、互いの間に静電容量を形成するように配置される内部電極であり、前記積層型セラミック電子部品は、積層セラミックコンデンサである、請求項 9 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 1 1】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストに

それぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体セラミック粉末である、請求項 1 ないし 8 のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 1 2】 前記内部回路要素膜は、コイル状に延びるコイル導体膜であり、前記積層型セラミック電子部品は、積層インダクタである、請求項 1 1 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項 1 3】 請求項 1 ないし 1 2 のいずれかに記載の製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品。

【請求項 1 4】 少なくともセラミック粉末と第 1 の有機溶剤とを含む 1 次混合物を分散処理する 1 次分散工程と、

前記 1 次分散工程を経た前記 1 次混合物に少なくとも有機バインダを加えた 2 次混合物を分散処理する 2 次分散工程と、

前記第 1 の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第 2 の有機溶剤を前記 1 次混合物および／または前記 2 次混合物に含ませる工程と、

前記 2 次分散工程の後、前記 2 次混合物を加熱処理することによって、前記第 1 の有機溶剤を選択的に除去する除去工程を備える、セラミックペーストの製造方法。

【請求項 1 5】 請求項 1 4 に記載の製造方法によって得られた、セラミックペースト。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

この発明は、積層型セラミック電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペーストおよびその製造方法に関するもので、特に、セラミック層間に形成される内部回路要素膜の厚みに起因する段差を吸収するために内部回路要素膜パターンのネガティブパターンをもって形成された段差吸収用セラミック層を備える、積層型セラミック電子部品およびその製造方法、ならびに、段差吸収用セラミック層を形成するのに有利に用いられるセラミックペーストおよびその製造方法に関するものである。

【0 0 0 2】

## 【従来の技術】

たとえば積層セラミックコンデンサのような積層型セラミック電子部品を製造しようとするとき、複数のセラミックグリーンシートが用意され、これらセラミックグリーンシートが積み重ねられる。特定のセラミックグリーンシート上には、得ようとする積層型セラミック電子部品の機能に応じて、コンデンサ、抵抗、インダクタ、バリスタ、フィルタ等を構成するための導体膜、抵抗体膜のような内部回路要素膜が形成されている。

## 【0003】

近年、移動体通信機器をはじめとする電子機器は、小型化かつ軽量化が進み、このような電子機器において、たとえば積層型セラミック電子部品が回路素子として用いられる場合、このような積層型セラミック電子部品に対しても、小型化および軽量化が強く要求されるようになっている。たとえば、積層セラミックコンデンサの場合には、小型化かつ大容量化の要求が高まっている。

## 【0004】

積層セラミックコンデンサを製造しようとする場合、典型的には、誘電体セラミック粉末、有機バインダ、可塑剤および有機溶剤を混合してセラミックスラリーを作製し、このセラミックスラリーを、剥離剤としてのシリコーン樹脂等によってコーティングされた、たとえばポリエステルフィルムのような支持体上で、ドクターブレード法等を適用して、たとえば厚さ数10  $\mu\text{m}$ のシート状となるように成形することによって、セラミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミックグリーンシートが乾燥される。

## 【0005】

次に、上述したセラミックグリーンシートの主面上に、互いに間隔を隔てた複数のパターンをもって、導電性ペーストをスクリーン印刷によって付与し、これを乾燥することにより、内部回路要素膜としての内部電極がセラミックグリーンシート上に形成される。図7には、上述のように複数箇所に分布して内部電極1が形成されたセラミックグリーンシート2の一部が平面図で示されている。

## 【0006】

次に、セラミックグリーンシート2が支持体から剥離され、適当な大きさに切

断された後、図 6 に一部を示すように、所定の枚数だけ積み重ねられ、さらに、この積み重ねの上下に内部電極を形成していないセラミックグリーンシートが所定の枚数だけ積み重ねられることによって、生の積層体 3 が作製される。

#### 【0007】

この生の積層体 3 は、積層方向にプレスされた後、図 8 に示すように、個々の積層セラミックコンデンサのための積層体チップ 4 となるべき大きさに切断され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付され、最終的に外部電極が形成されることによって、積層セラミックコンデンサが完成される。

#### 【0008】

このような積層セラミックコンデンサにおいて、その小型化かつ大容量化に対する要求を満足させるためには、セラミックグリーンシート 2 および内部電極 1 の積層数の増大およびセラミックグリーンシート 2 の薄層化を図ることが必要となってくる。

#### 【0009】

しかしながら、上述のような多層化および薄層化が進めば進むほど、内部電極 1 の各厚みの累積の結果、内部電極 1 が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは、内部電極 1 が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差がより顕著になり、たとえば、図 8 に示すように、得られた積層体チップ 4 の外観に関しては、その一方主面が凸状となるような変形が生じてしまう。

#### 【0010】

積層体チップ 4 において図 8 に示すような変形が生じていると、内部電極 2 が位置していない部分あるいは比較的小数の内部電極 1 しか積層方向に配列されていない部分においては、プレス工程の際に比較的大きな歪みがもたらされており、また、セラミックグリーンシート 2 間の密着性が劣っているため、焼成時に引き起こされる内部ストレスによって、デラミネーションや微小クラック等の構造欠陥が発生しやすい。

#### 【0011】

また、図 8 に示すような積層体チップ 4 の変形は、内部電極 1 を不所望に変形



させる結果を招き、これによって、ショート不良が生じることがある。

【0 0 1 2】

このような不都合は、積層セラミックコンデンサの信頼性を低下させる原因となっている。

【0 0 1 3】

上述のような問題を解決するため、たとえば、図 2 に示すように、セラミックグリーンシート 2 上の内部電極 1 が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層 5 を形成し、この段差吸収用セラミックグリーン層 5 によって、セラミックグリーンシート 2 上での内部電極 1 の厚みによる段差を実質的になくすことが、たとえば、特開昭 5 6 - 9 4 7 1 9 号公報、特開平 3 - 7 4 8 2 0 号公報、特開平 9 - 1 0 6 9 2 5 号公報等に記載されている。

【0 0 1 4】

上述のように、段差吸収用セラミックグリーン層 5 を形成することによって、図 1 に一部を示すように、生の積層体 3 a を作製したとき、内部電極 1 が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極 1 が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図 3 に示すように、得られた積層体チップ 4 a において、図 8 に示すような不所望な変形が生じにくくなる。

【0 0 1 5】

その結果、前述したようなデラミネーションや微小クラック等の構造欠陥および内部電極 1 の変形によるショート不良といった問題を生じにくくすることができ、得られた積層セラミックコンデンサの信頼性を高めることができる。

【0 0 1 6】

【発明が解決しようとする課題】

上述した段差吸収用セラミックグリーン層 5 は、セラミックグリーンシート 2 の場合と同様の組成を有し、誘電体セラミック粉末、有機バインダ、可塑剤および有機溶剤を含むセラミックペーストを付与することによって形成されるが、たとえば厚み 2  $\mu$  m 以下といった内部電極 1 と同程度の厚みを有するように、段差吸収用セラミックグリーン層 5 を高精度に印刷等によって形成するためには、セ

ラミックペースト中におけるセラミック粉末の分散性を優れたものとしなければならない。

【0017】

これに関連して、たとえば特開平 3－7 4 8 2 0 号公報では、セラミックペーストを得るため、3 本ロールによる分散処理が開示されているが、このような単なる 3 本ロールによる分散処理では、上述したような優れた分散性を得ることが困難である。

【0018】

他方、特開平 9－1 0 6 9 2 5 号公報では、セラミックグリーンシート 2 のためのセラミックスラリーを、誘電体セラミック粉末と有機バインダと低沸点の第 1 の有機溶剤とを混合することにより作製し、これをセラミックグリーンシート 2 の成形のために用いるとともに、このセラミックスラリーに対して、上述の第 1 の有機溶剤の沸点より高沸点の第 2 の有機溶剤を加えて混合した後、加熱し、低沸点の第 1 の有機溶剤を高沸点の第 2 の有機溶剤に置換することにより、段差吸収用セラミックグリーン層 5 のためのセラミックペーストを作製することが記載されている。

【0019】

したがって、上述したようにして得られたセラミックペーストにおいては、少なくとも 2 回の混合工程が実施されるので、セラミック粉末の分散性はある程度改善されるが、これらの混合工程では、いずれも、有機バインダを含んだ状態で実施されるため、混合時のスラリーまたはペーストの粘度は高く、たとえばボールミルのようなメディアを使った分散処理機では、セラミック粉末の分散性を優れたものとするには限界がある。

【0020】

このように、内部電極 1 の厚みと同等の厚みを有する段差吸収用セラミックグリーン層 5 といった極めて薄いセラミック層を形成するために用いるセラミックペーストとしては、そこに含まれるセラミック粉末に関して優れた分散性が要求され、このような優れた分散性に対する要求は、内部電極 1 の厚みが薄くなるほど厳しくなる。

## 【0 0 2 1】

また、段差吸収用セラミックグリーン層 5 におけるセラミック粉末の分散性が仮に悪い場合であっても、その上に重ねられるセラミックグリーンシート 2 によって、分散性の悪さをある程度カバーできることもあるが、セラミックグリーンシート 2 の厚みが薄くなると、このようなセラミックグリーンシート 2 によって分散性をカバーする効果をほとんど期待することができない。

## 【0 0 2 2】

以上のことから、積層セラミックコンデンサの小型化かつ大容量化が進むほど、段差吸収用セラミックグリーン層 5 におけるセラミック粉末に関してより高い分散性が必要となってくる。

## 【0 0 2 3】

なお、混合工程におけるセラミック粉末の分散効率を高めるため、セラミックペーストの粘度を低くすることが考えられるが、このように粘度を低くするため、前述した低沸点の有機溶剤の添加量を増すと、分散処理後において、この低沸点の有機溶剤を除去するため、長時間必要とするという別の問題に遭遇する。

## 【0 0 2 4】

以上、積層セラミックコンデンサに関連して説明を行なったが、同様の問題は、積層セラミックコンデンサ以外のたとえば積層インダクタといった他の積層型セラミック電子部品においても遭遇する。

## 【0 0 2 5】

そこで、この発明の目的は、上述したような問題を解決し得る、積層型セラミック電子部品の製造方法およびこの製造方法によって得られた積層型セラミック電子部品を提供しようとすることである。

## 【0 0 2 6】

この発明の他の目的は、前述した段差吸収用セラミック層のように極めて薄いセラミックグリーン層を形成するのに適したセラミックペーストを製造する方法およびこの製造方法によって得られたセラミックペーストを提供しようとすることである。

## 【0 0 2 7】

【課題を解決するための手段】

この発明は、まず、積層型セラミック電子部品の製造方法に向けられる。この製造方法では、基本的に、次のような工程が実施される。

【0028】

まず、セラミックスラリー、導電性ペーストおよびセラミックペーストがそれぞれ用意される。

【0029】

次に、セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、セラミックグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらすように部分的に導電性ペーストを付与することによって形成された内部回路要素膜と、内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成されない領域にセラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物が作製される。

【0030】

次に、これら複数の複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体が作製される。

【0031】

そして、生の積層体が焼成される。

【0032】

このような基本的工程を備える、積層型セラミック電子部品の製造方法において、この発明では、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストを用意する工程、すなわちセラミックペーストを製造する方法に特徴がある。

【0033】

この発明において、セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とが実施される。ここで、有機バインダは、2次分散工

程の段階において加えられることに注目すべきである。

【 0 0 3 4 】

また、この発明では、上述の第 1 の有機溶剤以外に、第 1 の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第 2 の有機溶剤が用いられることを特徴としている。この第 2 の有機溶剤は、1 次分散工程の段階で加えられても、2 次分散工程の段階で加えられても、あるいは、1 次分散工程の段階で加えられながら、さらに 2 次分散工程の段階で追加されてもよい。すなわち、第 2 の有機溶剤は、1 次混合物および／または 2 次混合物に含んでいる。

【 0 0 3 5 】

そして、最終的に、2 次分散工程の後、2 次混合物を加熱処理することによって、第 1 の有機溶剤を選択的に除去する除去工程が実施される。

【 0 0 3 6 】

上述したセラミックペーストの製造方法に含まれる 1 次分散工程において、1 次混合物は有機分散剤を含むことが好ましい。

【 0 0 3 7 】

また、上述した第 1 の有機溶剤の 2 0℃における相対蒸発速度は、1 0 0 以上であり、第 2 の有機溶剤の 2 0℃における相対蒸発速度は、5 0 以下であることが好ましい。

【 0 0 3 8 】

また、セラミックペーストの製造方法において、2 次分散工程の後であって、除去工程の前に、2 次混合物を濾過する工程がさらに実施されることが好ましい。

【 0 0 3 9 】

また、セラミックペーストの製造方法において、有機バインダを第 1 の有機溶剤および／または第 2 の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製する工程と、有機ビヒクルを濾過する工程とがさらに実施され、2 次混合物は、濾過工程を経た有機ビヒクルの状態で加えられた有機バインダを含んでいることが好ましい。

【 0 0 4 0 】

また、セラミックペーストの製造方法において、第 1 および第 2 の有機溶剤として、前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せが選ばれるが、このことは、通常の場合、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、容易に実現できる。

【 0 0 4 1 】

上述したような沸点の差によって第 1 および第 2 の有機溶剤の組合せを選択する場合、第 1 の有機溶剤の沸点と第 2 の有機溶剤の沸点との差は、5 0℃以上であることが好ましい。

【 0 0 4 2 】

この発明において、セラミックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーは、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むことが好ましい。

【 0 0 4 3 】

また、この発明の特定のな実施態様において、セラミックスラリーおよびセラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、誘電体セラミック粉末である。この場合、内部回路要素膜が、互いの間に静電容量を形成するように配置される内部電極であるとき、積層セラミックコンデンサを製造することができる。

【 0 0 4 4 】

また、この発明の他の特定のな実施態様において、セラミックスラリーおよびセラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体セラミック粉末である。この場合、内部回路要素膜が、コイル状に延びるコイル導体膜であるとき、積層インダクタを製造することができる。

【 0 0 4 5 】

この発明は、また、上述したような製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品にも向けられる。

【 0 0 4 6 】

また、この発明は、上述したようなセラミックペーストの製造方法およびこの

製造方法によって得られたセラミックペーストにも向けられる。

【0047】

【発明の実施の形態】

この発明の一実施形態の説明を、積層セラミックコンデンサの製造方法について行なう。この実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方法は、前述した図1ないし図3を参照しながら説明することができる。

【0048】

この実施形態を実施するにあたり、セラミックグリーンシート2のためのセラミックスラリー、内部電極1のための導電性ペーストおよび段差吸収用セラミックグリーン層5のためのセラミックペーストがそれぞれ用意される。

【0049】

上述のセラミックスラリーは、誘電体セラミック粉末、有機バインダ、可塑剤および比較的低沸点の有機溶剤を混合することによって作製される。このセラミックスラリーからセラミックグリーンシート2を得るため、剥離剤としてのシリコン樹脂等によってコーティングされた、たとえばポリエステルフィルムのような支持体（図示せず。）上で、セラミックスラリーがドクターブレード法等によって成形され、次いで乾燥される。セラミックグリーンシート2の各厚みは、乾燥後において、たとえば数 $\mu\text{m}$ とされる。

【0050】

上述のようなセラミックグリーンシート2の主面上には、複数箇所に分布するように、内部電極1が乾燥後においてたとえば約 $1\mu\text{m}$ の厚みをもって形成される。内部電極1は、たとえば、スクリーン印刷等によって導電性ペーストを付与し、これを乾燥することによって形成される。この内部電極1は、それぞれ、所定の厚みを有していて、したがって、セラミックグリーンシート2上には、この厚みによる段差がもたらされる。

【0051】

次に、上述した内部電極1の厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックグリーンシート2の主面上であって、内部電極1が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層5が形成される。段差吸収用セラミックグリ

ーン層 5 は、内部電極 1 のネガティブパターンをもって、前述したセラミックペーストをスクリーン印刷等によって付与することにより形成され、次いで乾燥される。ここで用いられるセラミックペーストは、この発明において特徴となるもので、その詳細については後述する。

【 0 0 5 2 】

上述した説明では、内部電極 1 を形成した後に段差吸収用セラミックグリーン層 5 を形成したが、逆に、段差吸収用セラミックグリーン層 5 を形成した後に内部電極 1 を形成するようにしてもよい。

【 0 0 5 3 】

上述のように、セラミックグリーンシート 2 上に内部電極 1 および段差吸収用セラミックグリーン層 5 が形成された、図 2 に示すような複合構造物 6 は、複数用意され、これら複合構造物 6 は、支持体より剥離された後、適当な大きさに切断され、所定の枚数だけ積み重ねられ、さらにその上下に内部電極および段差吸収用セラミックグリーン層が形成されていないセラミックグリーンシートを積み重ねることによって、図 1 に一部を示すような生の積層体 3 a が作製される。

【 0 0 5 4 】

この生の積層体 3 a は、積層方向にプレスされた後、図 3 に示すように、個々の積層セラミックコンデンサのための積層体チップ 4 a となるべき大きさに切断され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付され、最終的に外部電極が形成されることによって、積層コンデンサが完成される。

【 0 0 5 5 】

上述のように、段差吸収用セラミックグリーン層 5 を形成することによって、図 1 に一部を示すように、生の積層体 3 a において、内部電極 1 が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極 1 が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図 3 に示すように、積層体チップ 4 a において、不所望な変形が生じにくくなる。その結果、得られた積層セラミックコンデンサにおいて、デラミネーションや微小クラック等の構造欠陥およびショート不良といった問題を生じにくくすることができる。



【 0 0 5 6 】

この発明では、段差吸収用セラミックグリーン層 5 を形成するためのセラミックペーストを製造する方法に特徴があり、この特徴ある製造方法を採用することにより、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を高めることができる。

【 0 0 5 7 】

すなわち、この発明では、セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第 1 の有機溶剤とを含む 1 次混合物を分散処理する 1 次分散工程と、この 1 次分散工程を経た 1 次混合物に少なくとも有機バインダを加えた 2 次混合物を分散処理する 2 次分散工程とが実施される。

【 0 0 5 8 】

このように、1 次分散工程では、有機バインダを未だ加えていないので、低粘度下での分散処理を可能とし、そのため、セラミック粉末の分散性を高めることが容易である。この 1 次分散工程では、セラミック粉末の表面に吸着している空気が第 1 の有機溶剤で置換され、セラミック粉末を第 1 の有機溶剤で十分に濡らした状態とすることができるとともに、セラミック粉末の凝集状態を十分に解砕することができる。

【 0 0 5 9 】

また、2 次分散工程では、上述のように、1 次分散工程で得られたセラミック粉末の高い分散性を維持したまま、有機バインダを十分かつ均一に混合させることができ、また、セラミック粉末のさらなる粉砕効果も期待できる。

【 0 0 6 0 】

この発明では、上述の第 1 の有機溶剤以外に、第 1 の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第 2 の有機溶剤も用いられる。この第 2 の有機溶剤は、1 次分散工程の段階で加えられても、2 次分散工程の段階で加えられても、あるいは、1 次分散工程の段階で加えられながら、2 次分散工程の段階でも追加投入されてもよい。

【 0 0 6 1 】

そして、最終的に、2 次分散工程の後、2 次混合物を加熱処理することによっ

て、第 1 の有機溶剤が選択的に除去される。

【 0 0 6 2 】

このように、第 1 の有機溶剤の除去が、2 次分散工程の後に実施されるので、2 次分散工程の段階においても、2 次混合物の粘度を比較的低くしておくことが可能であり、したがって、分散効率を比較的高く維持しておくことができるとともに、前述したような 2 次分散工程の段階で加えられる有機バインダの溶解性を高めることができる。

【 0 0 6 3 】

上述のようにして得られたセラミックペーストは、有機溶剤としては、第 1 の有機溶剤がわずかに残存することがあっても、実質的に第 2 の有機溶剤のみを含んでいる。第 2 の有機溶剤は、第 1 の有機溶剤より相対蒸発速度が小さいため、セラミックペーストの乾燥速度を所定値以下に抑えることができ、たとえばスクリーン印刷を問題なく適用することを可能にする。

【 0 0 6 4 】

この発明において実施される 1 次分散工程および 2 次分散工程では、たとえばボールミルのようなメディアを用いる通常の分散処理機を適用して分散処理することができる。

【 0 0 6 5 】

この発明において、第 1 の有機溶剤または第 2 の有機溶剤として用いられる有機溶剤としては、種々のものがあり、このような有機溶剤の相対蒸発速度を考慮して、第 1 の有機溶剤として用いられるものおよび第 2 の有機溶剤として用いられるものをそれぞれ選択すればよい。

【 0 0 6 6 】

このような有機溶剤の例としては、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、アセトン等のケトン類、トルエン、ベンゼン、キシレン、ノルマルヘキサン等の炭化水素類、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、アミルアルコール等のアルコール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル等のエステル類、ジイソプロピルケトン、エチルセルソルブ、ブチルセルソルブ、セルソルブアセテート、メチルセルソルブアセテート、ブチルカルビトール、

シクロヘキサノール、パイン油、ジヒドロテルピネオール、イソホロン、テルピネオール、シプロピレングリコール、ジメチルフタレート等のケトン類、エステル類、炭化水素類、アルコール類、塩化メチレン等の塩化炭化水素類、およびこれらの混合物が挙げられる。

【0067】

より好ましくは、第1の有機溶剤としては、20℃における相対蒸発速度が100以上、さらに好ましくは150以上となる有機溶剤が選ばれる。除去工程での第1の有機溶剤の除去を速やかに終えるようにするためである。なお、相対蒸発速度とは、酢酸ノルマルブチル（沸点126.5℃）の蒸発速度を100としたときの相対的な蒸発速度である。

【0068】

第1の有機溶剤に適した相対蒸発速度が100以上の有機溶剤としては、たとえば、メチルエチルケトン（相対蒸発速度465）、メチルイソブチルケトン（同145）、アセトン（同720）、トルエン（同195）、ベンゼン（同500）、メタノール（同370）、エタノール（同203）、イソプロパノール（同205）、酢酸エチル（同525）、酢酸イソブチル（同152）、酢酸ブチル（同100）、およびこれらの混合物が挙げられる。

【0069】

他方、より好ましくは、第2の有機溶剤としては、20℃における相対蒸発速度が50以下となる有機溶剤が選択される。スクリーン印刷性を良好にするためである。

【0070】

第2の有機溶剤に適した相対蒸発速度が50以下の有機溶剤としては、たとえば、ジイソプロピルケトン（相対蒸発速度49）、メチルセルソルブアセテート（同40）、セルソルブアセテート（同24）、ブチルセルソルブ（同10）、シクロヘキサノール（同10以下）、パイン油（同10以下）、ジヒドロテルピネオール（同10以下）、イソホロン（同10以下）、テルピネオール（同10以下）、シプロピレングリコール（同10以下）、ジメチルフタレート（同10以下）、ブチルカルピトール（同40以下）、およびこれらの混合物が挙げられ

る。

#### 【 0 0 7 1 】

なお、第 1 および第 2 の有機溶剤をそれぞれ選択するにあたって、上述のように相対蒸発速度によるのではなく、沸点によることも可能であり、むしろ沸点による方が、第 1 および第 2 の有機溶剤の各々の選択が容易である。沸点による場合、第 1 および第 2 の有機溶剤として、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、大体において、前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せを選び出すことができる。

#### 【 0 0 7 2 】

前述した有機溶剤の例として挙げたもののいくつかについて、各々の沸点を括弧内に示すと、メチルエチルケトン（79.6℃）、メチルイソブチルケトン（118.0℃）、アセトン（56.1℃）、トルエン（111.0℃）、ベンゼン（79.6℃）、メタノール（64.5℃）、エタノール（78.5℃）、イソプロパノール（82.5℃）、酢酸エチル（77.1℃）、酢酸イソブチル（118.3℃）、ジイソプロピルケトン（143.5℃）、メチルセルソルブアセテート（143℃）、セルソルブアセテート（156.2℃）、ブチルセルソルブ（170.6℃）、シクロヘキサノール（160℃）、パイン油（195～225℃）、ジヒドロテルピネオール（210℃）、イソホロン（215.2℃）、テルピネオール（219.0℃）、シプロピレングリコール（231.8℃）、ジメチルフタレート（282.4℃）となるが、このような沸点に基づいて、第 1 および第 2 の有機溶剤をそれぞれ選択するようにすればよい。

#### 【 0 0 7 3 】

上述したような沸点の差によって第 1 および第 2 の有機溶剤の組合せを選択する場合、第 1 の有機溶剤の沸点と第 2 の有機溶剤の沸点との差は、50℃以上であることが好ましい。除去工程において、加熱処理による第 1 の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易にするためである。

#### 【 0 0 7 4 】

上述した高沸点の第 2 の有機溶剤に関して、スクリーン印刷性を考慮したとき、150℃以上の沸点を有していることが好ましく、200～250℃程度の沸

点を有していることがより好ましい。150℃未満では、セラミックペーストが乾燥しやすく、そのため、印刷パターンのメッシュの目詰まりが生じやすく、他方、250℃を超えると、印刷塗膜が乾燥しにくく、そのため、乾燥に長時間要するためである。

## 【0075】

セラミックペーストにおいて用いられる有機バインダとしては、室温で有機溶剤に溶解するものが良い。このような有機バインダとしては、たとえば、ポリビニルブチラール、ポリブチルブチラール等のポリアセタール類、ポリ（メタ）アクリル酸エステル類、エチルセルロース等の変性セルロース類、アルキッド類、ビニリデン類、ポリエーテル類、エポキシ樹脂類、ウレタン樹脂類、ポリアミド樹脂類、ポリイミド樹脂類、ポリアミドイミド樹脂類、ポリエステル樹脂類、ポリサルフォン樹脂類、液晶ポリマー類、ポリイミダゾール樹脂類、ポリオキサゾリン樹脂類等がある。

## 【0076】

有機バインダとして上に例示したポリビニルブチラールは、ポリビニルアルコールとブチルアルデヒドとの縮合によって得られるものであり、アセチル基が6モル%以下で、ブチラール基が62～82モル%の低重合品、中重合品および高重合品がある。この発明に係るセラミックペーストにおいて有機バインダとして用いられるポリビニルブチラールは、有機溶剤に対する溶解粘度および乾燥塗膜の強靱性のバランスから、ブチラール基が65モル%程度の中重合品であることが好ましい。

## 【0077】

有機バインダの添加量は、セラミック粉末に対して、1～20重量%、好ましくは、3～10重量%に選ばれる。

## 【0078】

上述した1次分散工程において、1次混合物は有機分散剤を含むことが好ましい。すなわち、1次混合物において、第1の有機溶剤または第1および第2の有機溶剤によって希釈された状態で、有機分散剤を添加すれば、セラミック粉末の分散性がより向上する。

## 【 0 0 7 9 】

上述の有機分散剤としては、特に限定しないが、分散性の点からは、分子量は 1 万以下であることが好ましい。アニオン系、カチオン系、ノニオン系いずれでもよいが、ポリアクリル酸やそのアンモニウム塩、ポリアクリル酸エステル共重合体、ポリエチレンオキサイド、ポリオキシエチレンアルキルアミルエーテル、脂肪酸ジエタノールアמיד、ポリエチレンイミン、ポリオキシプロピレンモノアシルモノブチルエーテルと無水マレイン酸（およびスチレン）の共重合体等が好ましい。

## 【 0 0 8 0 】

有機分散剤の添加量は、セラミック粉末に対して、0. 1 ～ 5 重量%、好ましくは、0. 5 ～ 2. 0 重量%に選ばれる。

## 【 0 0 8 1 】

また、2 次分散工程の後であって、除去工程の前に、2 次混合物を濾過する工程がさらに実施されることが好ましい。これによって、セラミックペースト中に存在することがある、異物、セラミック粉末の凝集物、有機バインダの未溶解物等を除去することができ、より分散性の高いセラミックペーストを確実に得ることができる。また、セラミック粉末に付着しているような微小径の空気が濾過によって破泡したり除去されたりすることにより、セラミックペーストからなる段差吸収用セラミックグリーン層 5 の焼成後にもたらされるセラミック層においてピンホールを減少させる効果も期待できる。

## 【 0 0 8 2 】

あるいは、有機バインダを第 1 の有機溶剤および／または第 2 の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを濾過した後、2 次混合物において、濾過工程を経た有機ビヒクルの状態で有機バインダが加えられてもよい。

## 【 0 0 8 3 】

また、上述のような 2 つの態様の濾過は、各々、複数回繰り返してもよく、また、2 つの態様の濾過を組み合わせてもよい。このように、濾過を複数回繰り返したり、2 つの態様の濾過を組み合わせたことにより、濾過による効果を

一層高めることができる。

【0084】

上述した濾過工程においては、ステンレス鋼からなるフィルタ、またはポリプロピレン、フッ素系樹脂等のプラスチックからなるフィルタが用いられ、濾過速度を高めるため、空気や窒素ガス等の圧縮ガスによって強制的に押し出したり、減圧下で吸引したりする方法が採用されてもよい。

【0085】

また、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末は、セラミックグリーンシート2を成形するために用いられるセラミックスラリーに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するものであることが好ましい。段差吸収用セラミックグリーン層4とセラミックグリーンシート2との間で焼結性を一致させるためである。

【0086】

なお、上述の実質的に同じ組成を有するとは、主成分が同じであるということである。たとえば、微量添加金属酸化物やガラス等の副成分が異なっても、実質的に同じ組成を有するということができる。また、セラミックグリーンシート2に含まれるセラミック粉末が、静電容量の温度特性についてJIS規格で規定するB特性およびEIA規格で規定するX7R特性を満足する範囲のものであれば、段差吸収用セラミックグリーン層4のためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末も、主成分が同じでB特性およびX7R特性を満足するものであれば、副成分が違っていてもよい。

【0087】

図4は、この発明の他の実施形態としての積層インダクタの製造方法を説明するためのものであり、図5に外観を斜視図で示した、この製造方法によって製造された積層インダクタ11に備える積層体チップ12を得るために用意される生の積層体13を構成する要素を分解して示す斜視図である。

【0088】

生の積層体13は、複数のセラミックグリーンシート14、15、16、17、…、18および19を備え、これらセラミックグリーンシート14～19を積

層することによって得られるものである。

【0089】

セラミックグリーンシート14～19は、磁性体セラミック粉末を含むセラミックスラリーを、ドクターブレード法等によって成形し、乾燥することによって得られる。セラミックグリーンシート14～19の各厚みは、乾燥後において、たとえば10～30 $\mu$ mとされる。

【0090】

セラミックグリーンシート14～19のうち、中間に位置するセラミックグリーンシート15～18には、以下に詳細に説明するように、コイル状に延びるコイル導体膜および段差吸収用セラミックグリーン層が形成される。

【0091】

まず、セラミックグリーンシート15上には、コイル導体膜20が形成される。コイル導体膜20は、その第1の端部がセラミックグリーンシート15の端縁にまで届くように形成される。コイル導体膜20の第2の端部には、ビアホール導体21が形成される。

【0092】

このようなコイル導体膜20およびビアホール導体21を形成するため、たとえば、セラミックグリーンシート15にビアホール導体21のための貫通孔をレーザーまたはパンチングなどの方法により形成した後、コイル導体膜20およびビアホール導体21となる導電性ペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、乾燥することが行なわれる。

【0093】

また、上述したコイル導体膜20の厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックグリーンシート15の主面上であって、コイル導体膜20が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層22が形成される。段差吸収用セラミックグリーン層22は、前述した、この発明において特徴となる磁性体セラミック粉末を含むセラミックペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、乾燥することによって形成される。

【0094】



次に、セラミックグリーンシート 1 6 上には、上述した方法と同様の方法によって、コイル導体膜 2 3、ビアホール導体 2 4 および段差吸収用セラミックグリーン層 2 5 が形成される。コイル導体膜 2 3 の第 1 の端部は、前述したビアホール導体 2 1 を介して、コイル導体膜 2 0 の第 2 の端部に接続される。ビアホール導体 2 4 は、コイル導体膜 2 3 の第 2 の端部に形成される。

## 【 0 0 9 5 】

次に、セラミックグリーンシート 1 7 上には、同様に、コイル導体膜 2 6、ビアホール導体 2 7 および段差吸収用セラミックグリーン層 2 8 が形成される。コイル導体膜 2 6 の第 1 の端部は、前述したビアホール導体 2 4 を介して、コイル導体膜 2 3 の第 2 の端部に接続される。ビアホール導体 2 7 は、コイル導体膜 2 6 の第 2 の端部に形成される。

## 【 0 0 9 6 】

上述したセラミックグリーンシート 1 6 および 1 7 の積層は、必要に応じて、複数回繰り返される。

## 【 0 0 9 7 】

次に、セラミックグリーンシート 1 8 上には、コイル導体膜 2 9 および段差吸収用セラミックグリーン層 3 0 が形成される。コイル導体膜 2 9 の第 1 の端部は、前述したビアホール導体 2 7 を介して、コイル導体膜 2 6 の第 2 の端部に接続される。コイル導体膜 2 9 は、その第 2 の端部がセラミックグリーンシート 1 8 の端縁にまで届くように形成される。

## 【 0 0 9 8 】

なお、上述したコイル導体膜 2 0、2 3、2 6 および 2 9 の各厚みは、乾燥後において、たとえば約 3 0  $\mu$ m 程度とされる。

## 【 0 0 9 9 】

このようなセラミックグリーンシート 1 4 ~ 1 9 をそれぞれ含む複数の複合構造物を積層して得られた生の積層体 1 3 において、各々コイル状に延びる複数のコイル導体膜 2 0、2 3、2 6 および 2 9 が、ビアホール導体 2 1、2 4 および 2 7 を介して順次接続されることによって、全体として複数ターンのコイル導体が形成される。

## 【0 1 0 0】

生の積層体 1 3 が焼成されることによって、図 5 に示す積層インダクタ 1 1 のための積層体チップ 1 2 が得られる。なお、生の積層体 1 3 は、図 4 では、1 個の積層体チップ 1 2 を得るためのものとして図示されているが、複数の積層体チップを得るためのものとして作製され、これを切断することによって、複数の積層体チップを取り出すようにしてもよい。

## 【0 1 0 1】

次いで、図 5 に示すように、積層体チップ 1 2 の相対向する各端部には、前述したコイル導体膜 2 0 の第 1 の端部およびコイル導体膜 2 9 の第 2 の端部にそれぞれ接続されるように、外部電極 3 0 および 3 1 が形成され、それによって、積層インダクタ 1 1 が完成される。

## 【0 1 0 2】

図 1 ないし図 3 を参照して説明した積層セラミックコンデンサまたは図 4 および図 5 を参照して説明した積層インダクタ 1 1 において、セラミックグリーンシート 2 または 1 4 ~ 1 9 あるいは段差吸収用セラミックグリーン層 5 または 2 2 、 2 5 、 2 8 および 3 0 に含まれるセラミック粉末としては、代表的には、アルミナ、ジルコニア、マグネシア、酸化チタン、チタン酸バリウム、チタン酸ジルコン酸鉛、フェライト-マンガン等の酸化物系セラミック粉末、炭化ケイ素、窒化ケイ素、サイアロン等の非酸化物系セラミック粉末が挙げられる。粉末粒径としては、好ましくは、平均 5  $\mu$ m 以下、より好ましくは、1  $\mu$ m の球形または粉砕状のものが使用される。

## 【0 1 0 3】

また、不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量が 0. 1 重量% 以下のチタン酸バリウムをセラミック粉末として用いる場合、このセラミック粉末に対して、微量成分として以下のような金属酸化物やガラス成分を含有させてもよい。

## 【0 1 0 4】

金属酸化物としては、酸化テルビウム、酸化ジスプロシウム、酸化ホルミウム、酸化エルビウム、酸化イッテルビウム、酸化マンガン、酸化コバルト、酸化ニ

ッケル、または酸化マグネシウム等がある。

【0105】

また、ガラス成分としては、 $\text{Li}_2 - (\text{SiTi})\text{O}_2 - \text{MO}$ （ただし、MOは $\text{Al}_2\text{O}_3$ または $\text{ZrO}_2$ ）、 $\text{SiO}_2 - \text{TiO}_2 - \text{MO}$ （ただし、MOはBaO、CaO、SrO、MgO、ZnOまたはMnO）、 $\text{Li}_2\text{O} - \text{B}_2\text{O}_3 - (\text{SiTi})\text{O}_2 + \text{MO}$ （ただし、MOは $\text{Al}_2\text{O}_3$ または $\text{ZrO}_2$ ）、 $\text{B}_2\text{O}_3 - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{MO}$ （ただし、MOはBaO、CaO、SrOまたはMgO）、または $\text{SiO}_2$ 等がある。

【0106】

また、図1ないし図3を参照して説明した積層セラミックコンデンサまたは図4および図5を参照して説明した積層インダクタ11において、内部電極1またはコイル導体膜20、23、26および29ならびにビアホール導体21、24および27の形成のための用いられる導電性ペーストとしては、たとえば、次のようなものを用いることができる。

【0107】

積層セラミックコンデンサにおいて用いられる導電性ペーストとしては、平均粒径が $0.02\mu\text{m} \sim 3\mu\text{m}$ 、好ましくは $0.05 \sim 0.5\mu\text{m}$ であって、Ag/Pdが60重量%/40重量%~80重量%/20重量%の合金からなる導電性粉末、ニッケル金属粉末または銅金属粉末等を含み、この粉末を100重量部と、有機バインダを2~20重量部（好ましくは5~10重量部）と、焼結抑制剤としてのAg、Au、Pt、Ti、Si、NiまたはCu等の金属レジネートを金属換算で約0.1~3重量部（好ましくは0.5~1重量部）と、有機溶剤を約35重量部とを、3本ロールで混練した後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用いることができる。

【0108】

積層インダクタ11において用いられる導電性ペーストとしては、Ag/Pdが80重量%/20重量%~100重量%/0重量%の合金またはAgからなる導電性粉末を含み、この粉末が100重量部に対して、上述した積層セラミック

コンデンサのための導電性ペーストの場合と同様の有機バインダと焼結抑制剤と有機溶剤とを同様の比率で 3 本ロールで混練した後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用いることができる。

【0109】

以下に、この発明を、実験例に基づいて、より具体的に説明する。

【0110】

【実験例 1】

実験例 1 は、積層セラミックコンデンサに関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において、この発明の特徴としての 1 次分散工程と 2 次分散工程とを採用したことによる効果を確認するために実施したものである。

【0111】

(セラミック粉末の準備)

まず、炭酸バリウム ( $\text{BaCO}_3$ ) および酸化チタン ( $\text{TiO}_2$ ) を 1 : 1 のモル比となるように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、脱水乾燥させた。次いで、温度 1000℃ で 2 時間仮焼した後、粉砕することによって、誘電体セラミック粉末を得た。

【0112】

(セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製)

先に準備したセラミック粉末 100 重量部と、ポリビニルブチラール (中重合品) 7 重量部と、可塑剤として DOP (フタル酸ジオクチル) 3 重量部と、メチルエチルケトン 30 重量部と、エタノール 20 重量部と、トルエン 20 重量部とを、直径 1 mm のジルコニア製玉石 600 重量部とともに、ボールミルに投入し、20 時間湿式混合を行なって、セラミックスラリーを得た。

【0113】

そして、このセラミックスラリーに対して、ドクターブレード法を適用して、厚さ 3  $\mu\text{m}$  (焼成後の厚みは 2  $\mu\text{m}$ ) のセラミックグリーンシートを成形した。乾燥は、80℃で、5 分間行なった。

【0 1 1 4】

(導電性ペーストの準備)

A g / P d = 7 0 / 3 0 の金属粉末 1 0 0 重量部と、エチルセルロース 4 重量部と、アルキッド樹脂 2 重量部と、A g 金属レジネート 3 重量部 (A g として 1 7 . 5 重量部) と、ブチルカルビトールアセテート 3 5 重量部とを、3 本ロールで混練した後、テルピネオール 3 5 重量部を加えて粘度調整を行なった。

【0 1 1 5】

(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

— 試料 1 —

先に準備した誘電体セラミック粉末 1 0 0 重量部と、メチルエチルケトン (相対蒸発速度 4 6 5) 7 0 重量部と、直径 1 m m のジルコニア製玉石 6 0 0 重量部とを、ボールミルに投入し、1 6 時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点 2 2 0 ° C のテルピネオール (相対蒸発速度 1 0 以下) 4 0 重量部と、エチルセルロース樹脂 5 重量部とを添加し、さらに、1 6 時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0 1 1 6】

次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、6 0 ° C の温浴中でエバポレータにより 2 時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール 1 0 ~ 2 0 重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0 1 1 7】

— 試料 2 —

先に準備した誘電体セラミック粉末 1 0 0 重量部と、メチルエチルケトン 7 0 重量部と、テルピネオール 3 0 重量部と、直径 1 m m のジルコニア製玉石 6 0 0 重量部とを、ボールミルに投入し、1 6 時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点 2 2 0 ° C のテルピネオール 1 0 重量部と、エチルセルロース樹脂 5 重量部とを添加し、さらに、1 6 時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0 1 1 8】

次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10～20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

## 【0119】

## －試料3－

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級アンモニウム塩分散剤（重量平均分子量1000）0.5重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点220℃のテルピネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

## 【0120】

次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10～20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

## 【0121】

## －試料4－

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、沸点220℃のテルピネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

## 【0122】

## （積層セラミックコンデンサの作製）

先に用意したセラミックグリーンシートの主面上に内部電極を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。なお、内部電極の寸法、形状および位置は、後の工程で得られる積層体チップに適合するように設定した。次に、セラミックグリーンシートの主面上に段差吸収用セラミックグリーン層を形成するため、試料1ないし4に係る各セラミックペーストをスク

リーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。内部電極および段差吸収用セラミックグリーン層の各厚みは、乾燥後において、1  $\mu\text{m}$ （焼成後の厚みは0.5  $\mu\text{m}$ ）になるようにした。

【0 1 2 3】

次に、上述のように内部電極および段差吸収用セラミックグリーン層を形成している200枚のセラミックグリーンシートを、内部電極等が付与されていない数10枚のセラミックグリーンシートで挟み込むように積み重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、80℃で1000  $\text{Kg}/\text{cm}^2$  の加圧条件で熱プレスした。

【0 1 2 4】

次に、焼成後において長さ3.2  $\text{mm}$ ×幅1.6  $\text{mm}$ ×厚み1.6  $\text{mm}$ の寸法となるように、上述の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数の積層体チップを得た。

【0 1 2 5】

次に、ジルコニア粉末が少量散布された焼成用セッター上に、上述の複数の積層体チップを整列させ、室温から250℃まで24時間かけて昇温させ、有機バインダーを除去した。次に、積層体チップを、焼成炉に投入し、最高1300℃で約20時間のプロファイルにて焼成を行なった。

【0 1 2 6】

次に、得られた焼結体チップをバレルに投入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に外部電極を設けて、試料となる積層セラミックコンデンサを完成させた。

【0 1 2 7】

（特性の評価）

上述した試料1ないし4に係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、各種特性を評価した。その結果が表1に示されている。

【0 1 2 8】

【表 1】

試料番号	1	2	3	4
固形分(wt%)	65	64	66	67
粘度(Pa・s)	9	8	10	12
分散度	0	0	-0.2	0.3
印刷厚み(μm)	4	4	3	5
Ra(μm)	0.5	0.5	0.3	1.5
構造欠陥不良率(%)	2	3	0	80

【0 1 2 9】

表 1 における特性評価は、次のように行なった。

【0 1 3 0】

「固形分」：セラミックペースト約 1 g を精秤し、熱対流式オープンにおいて、1 5 0℃で 3 時間放置した後の重量から算出した。

【0 1 3 1】

「粘度」：セラミックペーストの粘度を、東京計器製 E 型粘度計を用いて、2 0℃において、2. 5 r p m の回転を付与して測定した。

【0 1 3 2】

「分散度」：セラミック粉末の粒度分布を光回折式粒度分布測定装置を用いて測定し、得られた粒度分布から算出した。すなわち、先に準備したセラミック粉末を、超音波ホモジナイザーを用いて水中で分散させ、粒経がこれ以上小さくならないところまで超音波を印加し、そのときの D 9 0 の粒経を記録して、これを限界粒経とした。他方、セラミックペーストをエタノール中で希釈し、粒度分布の D 9 0 の粒経を記録して、これをペーストの粒経とした。そして、

分散度 = (ペーストの粒経 / 限界粒経) - 1

の式に基づき、分散度を算出した。この分散度は、数値が + であれば、値が 0 に近いほど、分散性が良いことを示し、数値が - であれば、絶対値が大きいほど、分散性が良いことを示している。

【0 1 3 3】

「印刷厚み」：9 6 % アルミナ基板上に、4 0 0 メッシュで厚み 5 0 μ m のステンレス鋼製スクリーンを用いて、乳剤厚み 2 0 μ m で印刷し、8 0℃で 1 0 分



間乾燥することにより、評価用印刷塗膜を形成し、その厚みを、比接触式のレーザ表面粗さ計による測定結果から求めた。

【0 1 3 4】

「R a（表面粗さ）」：上記「印刷厚み」の場合と同様の評価用印刷塗膜を形成し、その表面粗さ R a、すなわち、うねりを平均化した中心線と粗さ曲線との偏差の絶対値を平均化した値を、比接触式のレーザ表面粗さ計による測定結果から求めた。

【0 1 3 5】

「構造欠陥不良率」：得られた積層セラミックコンデンサのための焼結体チップの外観検査、超音波顕微鏡による検査で異常が見られた場合、研磨により内部の構造欠陥を確認し、（構造欠陥のある焼結体チップ数）／（焼結体チップの総数）を構造欠陥不良率とした。

【0 1 3 6】

表 1 を参照すれば、1 次分散工程と 2 次分散工程とを採用し、2 次分散工程において有機バインダを添加した、試料 1～3 によれば、このようなことを行なわなかった試料 4 に比べて、優れた分散性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示していることがわかる。

【0 1 3 7】

【実験例 2】

実験例 2 は、上記実験例 1 と同様、積層セラミックコンデンサに関するものであるが、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において、濾過工程を付加したことによる効果を確認するために実施したものである。

【0 1 3 8】

以下の段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備工程を除いて、前述した実験例 1 と同様の工程を実施して、積層セラミックコンデンサを作製した。

【0 1 3 9】

(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

－試料 5－

実験例 1 における試料 1 の場合と同様の操作を経て得られたセラミックスラリー混合物を、絶対濾過  $20\ \mu\text{m}$  (99.7%の確率で  $10\ \mu\text{m}$  以上のものを除去できる) のフィルタによって加圧下で濾過した。

【0 1 4 0】

その後、実験例 1 における試料 1 の場合と同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を処理して、セラミックペーストを得た。

【0 1 4 1】

－試料 6－

上記試料 5 の場合において実施された絶対濾過  $20\ \mu\text{m}$  のフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過  $1\ \mu\text{m}$  のフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試料 5 の場合と同様の操作を実施して、セラミックペーストを得た。

【0 1 4 2】

－試料 7－

沸点  $220^\circ\text{C}$  のテルピネオール 40 重量部と、メチルエチルケトン 10 重量部と、エチルセルロース樹脂 5 重量部とを、プラネタリーミキサーにて混合することによって、エチルセルロース樹脂をテルピネオールおよびメチルエチルケトンに溶解させた有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを絶対濾過  $20\ \mu\text{m}$  のフィルタによって加圧下で濾過したものを用意した。

【0 1 4 3】

他方、先に準備した誘電体セラミック粉末 100 重量部と、メチルエチルケトン 60 重量部と、直径  $1\text{mm}$  のジルコニア製玉石 600 重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間湿式混合を行なった。

【0 1 4 4】

次に、同じポットに、前述のように予め用意された濾過後の有機ビヒクルを加え、さらに、16 時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0 1 4 5】

その後、実験例 1 における試料 1 の場合と同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を処理して、セラミックペーストを得た。

【0 1 4 6】

－試料 8－

上記試料 7 の場合において実施された絶対濾過 20  $\mu\text{m}$  のフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過 1  $\mu\text{m}$  のフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試料 7 の場合と同様の操作を実施して、セラミックペーストを得た。

【0 1 4 7】

－試料 9－

試料 7 の場合において実施された操作に加えて、試料 5 の場合において実施されたセラミックスラリー混合物の濾過をさらに実施することによって、セラミックペーストを得た。

【0 1 4 8】

上述した試料 5 ないし 9 に係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、各種特性を評価した結果が、表 2 に示されている。

【0 1 4 9】

【表 2】

試料番号	5	6	7	8	9
固形分(wt%)	66	67	66	67	68
粘度(Pa·s)	10	12	15	14	16
分散度	-0.1	-0.2	0	0	-0.3
印刷厚み( $\mu\text{m}$ )	3	2	3	2	2
Ra( $\mu\text{m}$ )	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2
構造欠陥不良率(%)	1.5	1	1.5	1	0

【0 1 5 0】

表 2 における特性評価方法は、表 1 の場合と同様である。

【0 1 5 1】

表 2 における試料 5 は、表 1 における試料 1 と比較して、セラミックスラリー混合物を濾過している点でのみ異なっているので、試料 5 を試料 1 と比較すれば、濾過による効果を確認することができる。すなわち、試料 5 によれば、試料 1

に比べて、より優れた分散性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示している。

【0 1 5 2】

また、表 2 において、試料 5 と試料 6 との比較、試料 7 と試料 8 との比較、あるいは、試料 5 または 7 と試料 9 との比較をそれぞれ行なうと、濾過工程に関して、これを複数回行なったり、異なる態様の濾過を組み合わせたりすることにより、濾過による効果を一層高め得ることがわかる。

【0 1 5 3】

【実験例 3】

実験例 3 は、上記実験例 1 および 2 と同様、積層セラミックコンデンサに関するものであるが、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において用いられる第 1 および第 2 の有機溶剤の各々についての相対蒸発速度の好ましい範囲を確認するために実施したものである。

【0 1 5 4】

以下に記載する、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備工程を除いて、前述した実験例 1 と同様の工程を実施して、積層セラミックコンデンサを作製した。

【0 1 5 5】

(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

－試料 1 0－

実験例 1 における試料 1 と比較して、第 1 の有機溶剤として、相対蒸発速度が 1 0 0 の酢酸ノルマルブチルを用いたことを除いて、試料 1 の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0 1 5 6】

－試料 1 1－

実験例 1 における試料 1 と比較して、第 1 の有機溶剤として、相対蒸発速度が 7 2 0 のアセトンを用いたことを除いて、試料 1 の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0 1 5 7】

## - 試料 1 2 -

実験例 1 における試料 1 と比較して、第 1 の有機溶剤として、相対蒸発速度が 83 のイソブチルアルコールを用いたことを除いて、試料 1 の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0 1 5 8】

## - 試料 1 3 -

実験例 1 における試料 1 と比較して、第 1 の有機溶剤として、相対蒸発速度が 370 のメタノールを用い、かつ、第 2 の有機溶剤として、相対蒸発速度が 55 のメチルセルソルブを用いたことを除いて、試料 1 の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0 1 5 9】

上述した試料 1 0 ないし 1 3 に係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、用いた第 1 および第 2 の有機溶剤の種類および各種特性を評価した結果が、表 3 に示されている。

【0 1 6 0】

【表 3】

試料番号	10	11	12	13
第1の有機溶剤 (相対蒸発速度)	酢酸ノルマルブチル (100)	アセトン (720)	イソブチルアルコール (83)	メタノール (370)
第2の有機溶剤 (相対蒸発速度)	テルピネオール (10以下)	テルピネオール (10以下)	テルピネオール (10以下)	メチルセルソルブ (55)
蒸発時間(Hr)	2	1	4	蒸発がいつまでも 止まらない
固形分(wt%)	70	67	66	—
粘度(Pa・s)	15	9	10	—
分散度	0.2	0	0.4	—
Ra(μm)	0.7	0.5	1.0	—
構造欠陥不良率(%)	3	2	10	—

【0 1 6 1】

表 3 において、「蒸発時間」は、減圧蒸留開始時から有機溶剤（通常、第 1 の有機溶剤）が蒸発しなくなるまでの時間を示したものである。表 3 におけるその

他の特性についての評価方法は、表 1 の場合と同様である。

【0 1 6 2】

表 3 を参照して、第 1 の有機溶剤として、相対蒸発速度が 1 0 0 以上のものを用い、かつ、第 2 の有機溶剤として、相対蒸発速度が 5 0 以下のものが用いられた、試料 1 0 および 1 1 によれば、第 1 の有機溶剤の蒸発を迅速に終えることができるとともに、分散性、表面粗さおよび構造欠陥不良率の点でも好ましい結果を得ることができる。

【0 1 6 3】

これに対して、第 2 の有機溶剤の相対蒸発速度は 5 0 以下であるが、第 1 の有機溶剤の相対蒸発速度が 1 0 0 未満である、試料 1 2 では、第 1 の有機溶剤を迅速に蒸発させることができず、また、分散性、表面粗さおよび構造欠陥不良率の点においても、試料 1 0 および 1 1 に比べて劣っている。

【0 1 6 4】

また、第 1 の有機溶剤の相対蒸発速度は 1 0 0 以上であるが、第 2 の有機溶剤の相対蒸発速度が 5 0 を超える、試料 1 3 では、第 2 の有機溶剤についての蒸発が長時間続き、たとえば、スクリーン印刷を実施している間にセラミックペーストの乾燥が進むため、スクリーンの目詰まり等を生じ、良好なスクリーン印刷を達成することが困難になる。

【0 1 6 5】

【実験例 4】

実験例 4 は、積層インダクタに関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において、この発明の特徴としての 1 次分散工程と 2 次分散工程とを採用したことによる効果を確認するために実施したものである。

【0 1 6 6】

(セラミック粉末の準備)

酸化第二鉄が 4 9 . 0 モル%、酸化亜鉛が 2 9 . 0 モル%、酸化ニッケルが 1 4 . 0 モル%、および酸化銅が 8 . 0 モル%となるように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、脱水乾燥させた。次いで、7 5 0 ℃で 1 時間仮焼した後

、粉碎することによって、磁性体セラミック粉末を得た。

【0 1 6 7】

(セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製)

先に準備した磁性体セラミック粉末 1 0 0 重量部と、ポリビニルブチラール（中重合品）7 重量部と、可塑剤として D O P（フタル酸ジオクチル）3 重量部と、メチルエチルケトン 3 0 重量部と、エタノール 2 0 重量部と、トルエン 2 0 重量部とを、直径 1 m m のジルコニア製玉石 6 0 0 重量部とともに、ボールミルに投入し、2 0 時間湿式混合を行なって、セラミックスラリーを得た。

【0 1 6 8】

そして、このセラミックスラリーに対して、ドクターブレード法を適用して、厚さ 2 0  $\mu$  m（焼成後の厚みは 1 5  $\mu$  m）のセラミックグリーンシートを成形した。乾燥は、8 0  $^{\circ}$  C で、5 分間行なった。

【0 1 6 9】

(導電性ペーストの準備)

A g / P d = 7 0 / 3 0 の金属粉末 1 0 0 重量部と、エチルセルロース 4 重量部と、アルキッド樹脂 2 重量部と、A g 金属レジネート 3 重量部（A g として 1 7 . 5 重量部）と、ブチルカルビトールアセテート 3 5 重量部とを、3 本ロールで混練した後、テルピネオール 3 5 重量部を加えて粘度調整を行なった。

【0 1 7 0】

(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

ー試料 1 4ー

先に準備した磁性体セラミック粉末 1 0 0 重量部と、メチルエチルケトン（相対蒸発速度 4 6 5）7 0 重量部と、直径 1 m m のジルコニア製玉石 6 0 0 重量部とを、ボールミルに投入し、1 6 時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点 2 2 0  $^{\circ}$  C のテルピネオール（相対蒸発速度 1 0 以下）4 0 重量部と、エチルセルロース樹脂 5 重量部とを添加し、さらに、1 6 時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0 1 7 1】

次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、6 0  $^{\circ}$  C の温浴中でエバポレータ

により 2 時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール 1 0 ～ 2 0 重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

## 【0 1 7 2】

## －試料 1 5－

先に準備した磁性体セラミック粉末 1 0 0 重量部と、メチルエチルケトン 7 0 重量部と、テルピネオール 3 0 重量部と、直径 1 mm のジルコニア製玉石 6 0 0 重量部とを、ボールミルに投入し、1 6 時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点 2 2 0 ℃ のテルピネオール 1 0 重量部と、エチルセルロース樹脂 5 重量部とを添加し、さらに、1 6 時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

## 【0 1 7 3】

次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、6 0 ℃ の温浴中でエバポレータにより 2 時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール 1 0 ～ 2 0 重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

## 【0 1 7 4】

## －試料 1 6－

先に準備した磁性体セラミック粉末 1 0 0 重量部と、メチルエチルケトン 7 0 重量部と、ポリアクリル酸 4 級アンモニウム塩分散剤（重量平均分子量 1 0 0 0 ） 0. 5 重量部と、直径 1 mm のジルコニア製玉石 6 0 0 重量部とを、ボールミルに投入し、1 6 時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点 2 2 0 ℃ のテルピネオール 1 0 重量部と、エチルセルロース樹脂 5 重量部とを添加し、さらに、1 6 時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

## 【0 1 7 5】

次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、6 0 ℃ の温浴中でエバポレータにより 2 時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール 1 0 ～ 2 0 重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。



## 【0 1 7 6】

## ー試料 1 7ー

先に準備した磁性体セラミック粉末 1 0 0 重量部と、沸点 2 2 0℃のテルピネオール 4 0 重量部と、エチルセルロース樹脂 5 重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3 本ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

## 【0 1 7 7】

## (積層インダクタの作製)

複数の磁性体セラミックグリーンシートの積層後にコイル状に延びるコイル導体が形成できるように、先に用意した磁性体セラミックグリーンシートの所定の位置に、ビアホール導体のための貫通孔を形成するとともに、磁性体セラミックグリーンシートの主面上にコイル導体膜および貫通孔内にビアホール導体を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、8 0℃で 1 0 分間乾燥した。次に、磁性体セラミックグリーンシート上に、段差吸収用磁性体セラミックグリーン層を形成するため、試料 1 4 ないし 1 7 に係る各磁性体セラミックペーストをスクリーン印刷し、8 0℃で 1 0 分間乾燥した。コイル導体膜および段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の各厚みは、乾燥後において、3 0  $\mu$ m (焼成後の厚みは 2 0  $\mu$ m) になるようにした。

## 【0 1 7 8】

次に、上述のようにコイル導体膜およびビアホール導体ならびに段差吸収用セラミックグリーン層を形成している 1 1 枚の磁性体セラミックグリーンシートを、コイル導体が形成されるように重ねるとともに、その上下にコイル導体膜等を形成していない磁性体セラミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、8 0℃で 1 0 0 0 K g / c m<sup>2</sup> の加圧下で熱プレスした。

## 【0 1 7 9】

次に、焼成後において長さ 3 . 2 mm × 幅 1 . 6 mm × 厚み 1 . 6 mm の寸法となるように、上述の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数の積層体チップを得た。

## 【0 1 8 0】

次に、上述の積層体チップを 4 0 0℃で 2 時間加熱することによって、有機バ

インダを除去した後、900℃で90分間の焼成を行なった。

【0181】

次に、得られた焼結体チップをバレルに投入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に主成分が銀である外部電極を設けて、試料となるチップ状の積層インダクタを完成させた。

【0182】

(特性の評価)

上述した試料1ないし4に係るセラミックペーストおよび積層インダクタについて、各種特性を評価した結果が表4に示されている。

【0183】

【表4】

試料番号	14	15	16	17
固形分(wt%)	72	73	72	73
粘度(Pa・s)	15	14	17	18
分散度	0	0	-0.3	0.2
印刷厚み(μm)	20	21	19	19
Ra(μm)	0.5	0.5	0.2	1.6
構造欠陥不良率(%)	1	1	0	50

【0184】

表4における特性評価方法は、表1の場合と同様である。

【0185】

表4を参照すれば、表1に示した実験例1の場合と同様、1次分散工程と2次分散工程とを採用し、2次分散工程において有機バインダを添加した、試料14～16によれば、このようなことを行なわなかった試料17に比べて、優れた分散性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示していることがわかる。

【0186】

以上、この発明に係るセラミックペーストに含まれるセラミック粉末として、誘電体セラミック粉末または磁性体セラミック粉末が用いられる場合について説明したが、この発明では、用いられるセラミック粉末の電気的特性に左右される

ものではなく、したがって、たとえば、絶縁体セラミック粉末あるいは圧電体セラミック粉末等を用いても、同様の効果を期待できるセラミックペーストを得ることができる。

## 【0187】

## 【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、セラミックペーストを製造するにあたって、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程と、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を1次混合物および／または2次混合物に含ませる工程と、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤を選択的に除去する除去工程とが実施されるので、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を優れたものとすることができる。そのため、極めて薄いセラミックグリーン層を、高いパターン精度をもって形成しなければならない場合において、このようなセラミックペーストを有利に用いることができる。

## 【0188】

したがって、この発明によれば、積層型セラミック電子部品において、内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成されない領域に段差吸収用セラミックグリーン層を形成するために、上述のようなセラミックペーストが用いられることによって、クラックやデラミネーション等の構造欠陥のない信頼性の高い積層型セラミック電子部品を実現することができる。

## 【0189】

また、この発明によれば、積層型セラミック電子部品の小型化かつ軽量化の要求に十分に対応することが可能となり、この発明が積層セラミックコンデンサに適用された場合、積層セラミックコンデンサの小型化かつ大容量化を有利に図ることができる。また、この発明が積層インダクタに適用された場合、積層インダクタの小型化かつ高インダクタンス化を有利に図ることができる。

【0 1 9 0】

上述した 1 次分散工程において、1 次混合物に有機分散剤を含ませるようにすると、セラミック粉末の分散性をより向上させることができる。

【0 1 9 1】

また、上述した第 1 の有機溶剤の 2 0 ℃における相対蒸発速度が 1 0 0 以上とされ、第 2 の有機溶剤の 2 0 ℃における相対蒸発速度が 5 0 以下とされると、除去工程での第 1 の有機溶剤の除去を速やかに終えることができるとともに、スクリーン印刷性を良好にすることができる。

【0 1 9 2】

また、2 次分散工程の後であって、除去工程の前に、2 次混合物を濾過する工程をさらに実施したり、有機バインダを第 1 の有機溶剤および／または第 2 の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを濾過した後、2 次混合物に含ませるようにしたりすれば、セラミックペースト中に存在することがある、異物、セラミック粉末の凝集物、有機バインダの未溶解物等を除去することができ、より分散性の高いセラミックペーストを確実に得ることができる。また、焼成後のセラミック層においてピンホールを減少させる効果も期待できる。

【0 1 9 3】

また、第 1 および第 2 の有機溶剤として、前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せを選ぶため、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、第 1 および第 2 の有機溶剤の選択が容易になる。

【0 1 9 4】

上述したような沸点の差によって第 1 および第 2 の有機溶剤の組合せを選択する場合、第 1 の有機溶剤の沸点と第 2 の有機溶剤の沸点との差を、5 0 ℃以上とすることにより、除去工程において、加熱処理による第 1 の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易にすることができる。

【0 1 9 5】

また、この発明に係る積層型セラミック電子部品の製造方法において、セラミ

ックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーが、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むようにすると、セラミックグリーンシートと段差吸収用セラミックグリーン層との焼結性を一致させることができ、このような焼結性の不一致によるクラックやデラミネーションの発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

この発明にとって興味ある、かつこの発明の一実施形態による、積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するためのもので、生の積層体 3 a の一部を図解的に示す断面図である。

【図 2】

図 1 に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される複合構造物 6 の一部を破断して示す平面図である。

【図 3】

図 1 に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される積層体チップ 4 a を図解的に示す断面図である。

【図 4】

この発明の他の実施形態による積層インダクタを製造するために用意される生の積層体 1 3 を構成する要素を分解して示す斜視図である。

【図 5】

図 4 に示した生の積層体 1 3 を焼成して得られた積層体チップ 1 2 を備える積層インダクタ 1 1 の外観を示す斜視図である。

【図 6】

この発明にとって興味ある従来の積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するためのもので、生の積層体 3 の一部を図解的に示す断面図である。

【図 7】

図 6 に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される内部電極 1 が形成されたセラミックグリーンシート 2 の一部を示す平面図である。

【図 8】

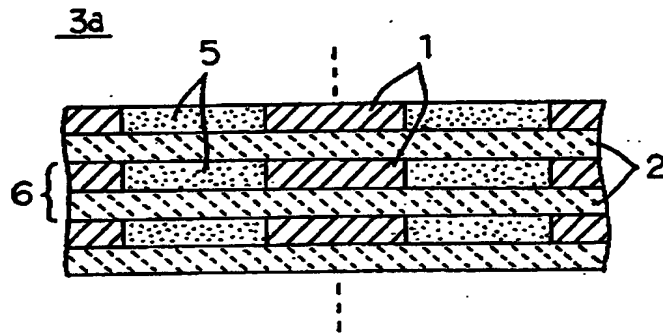
図 6 に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される積層体チップ 4 を図解的に示す断面図である。

【符号の説明】

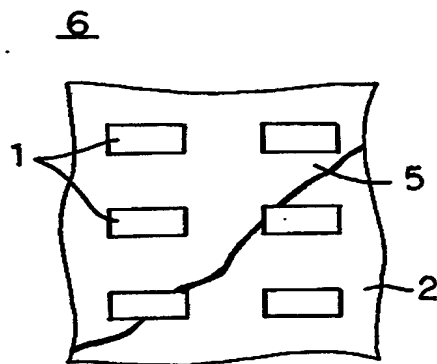
- 1 内部電極（内部回路要素膜）
- 2, 14～19 セラミックグリーンシート
- 3 a, 13 生の積層体
- 4 a, 12 積層体チップ
- 5, 22, 25, 28, 30 段差吸収用セラミックグリーン層
- 6 複合構造物
- 11 積層インダクタ（積層型セラミック電子部品）
- 20, 23, 26, 29 コイル導体膜（内部回路要素膜）

【書類名】 図面

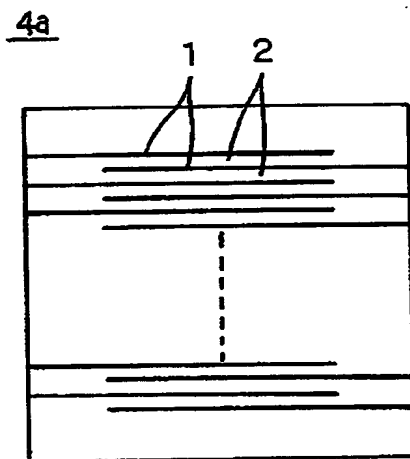
【図 1】



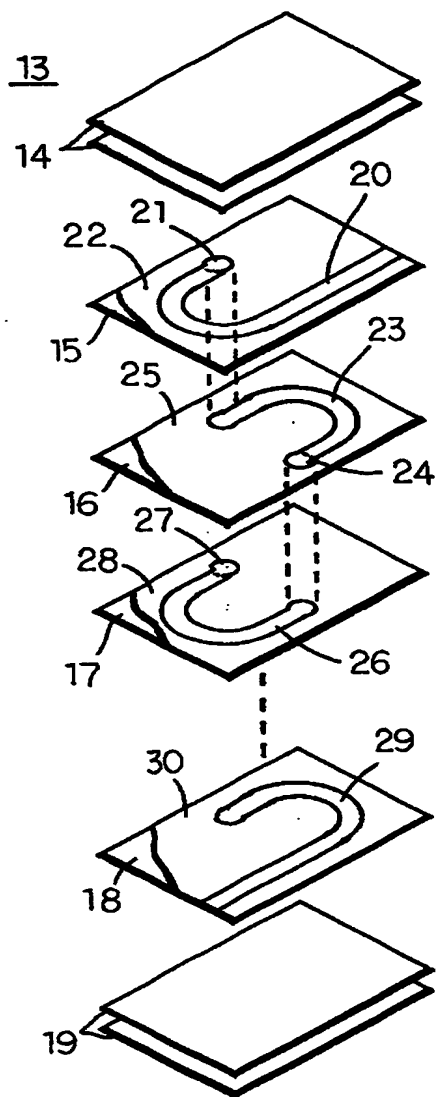
【図 2】



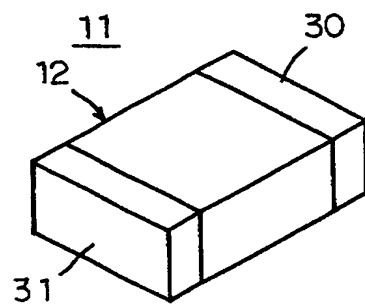
【図 3】



【図 4】

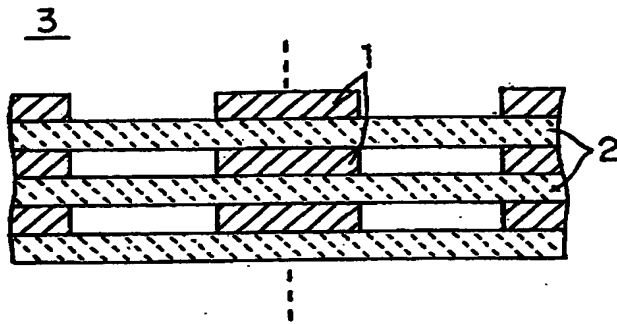


【図 5】

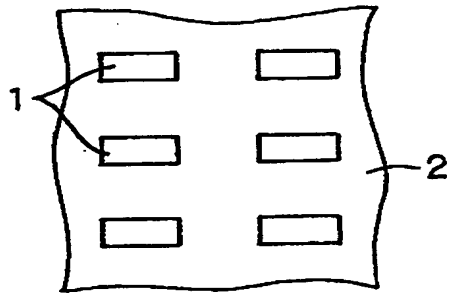




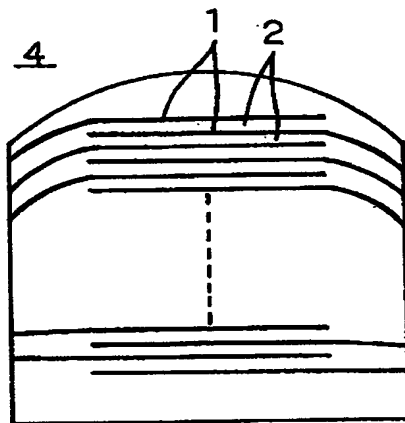
【図 6】



【図 7】



【図 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 そこに含まれるセラミック粉末の分散性が高められたセラミックペーストを提供する。

【解決手段】 セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第 1 の有機溶剤とを含む 1 次混合物を分散処理する 1 次分散工程と 1 次混合物に少なくとも有機バインダを加えた 2 次混合物を分散処理する 2 次分散工程とを実施する。1 次混合物および／または 2 次混合物は、第 1 の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第 2 の有機溶剤を含んでいる。そして、2 次分散工程の後、2 次混合物を加熱処理することによって、第 1 の有機溶剤を選択的に除去する。このセラミックペーストは、たとえば積層セラミックコンデンサにおける内部電極 1 の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシート 2 の主面上に段差吸収用セラミックグリーン層 5 を形成するために有利に用いられる。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 0 0 6 2 3 1 ]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 8 日

[ 変更理由 ] 新規登録

住 所 京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号

氏 名 株式会社村田製作所